

深圳市德明利技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	民生加银、博时基金、华安基金、申万菱信、泰康资产、天弘基金、民生证券、中泰证券
时间	2023年9月21日上午11:00-12:00 2023年9月22日上午15:00-16:00
地点	深圳市福田区新一代产业园1栋A座24楼公司会议室
上市公司接待人员	李虎、徐中辅、于海燕、李格格、彭震
形式	现场交流
交流内容及具体问答记录	<p>1、目前下游复苏情况怎么样，价格整体反弹力度如何？</p> <p>从公开报道可以看到三季度存储原厂仍持续保持减产，同时华为回归和苹果新机型发布有望加速渠道库存消化，目前现货市场已经开始接受小幅涨价，短期看供需关系逐渐改善，但未来宏观经济情况与下游需求复苏，以及存储原厂的产能策略均有不确定性，反弹力度暂时无法预估。</p> <p>2、公司能介绍一下自研主控的主要优势体现在什么地方？</p> <p>首先，自研主控作为存储器产品的核心器件之一，不同容量存储器中成本占比有所不同，公司采用自研主控，能够降低存储器产品成本，提高公司产品综合毛利率，更好地应对存储晶圆价格周期波动。其次，自研主控能够帮助公司更灵活地更高效地进行产品功能开发和调整，例如：特定领域客户提出定制化功能需求，公司能够快速响应进行定向开发，拓宽下游应用；在存储晶圆技术迭代期，公司可以通过调整主控和固件，更快稳定产品性能，形成先发优势。最后，自研主控可以帮助公司更好地维护上下游关系，自研主控的研发与优化需要同时匹配存储晶圆厂技术特征和下游实际应用需求，有助于公司与二者保持黏性，巩固供应链关系。</p>

3、公司预计未来业绩增长主要来自哪些板块？

公司各个产品板块仍处有较大的增长空间，2023 年上半年，公司移动存储营收同比增长 20.26%，固态硬盘营收同比增长 96.92%，同时公司嵌入式存储产品正在积极推动客户验证与导入，未来也将提供新的业绩增长点。此外随着晶圆与模组产品的价格上涨，有望进一步推动公司业绩规模增长。

4、公司上半年固态硬盘和嵌入式存储业务规模怎么样？

今年上半年，公司固态硬盘和嵌入式存储相关业务取得了预期进展。固态硬盘 2022 年、2023 年半年度销售额分别为 1.85 亿元、1.59 亿元，未来随着公司自研主控导入，以及 PC OEM 和企业级 SSD 业务拓展，固态硬盘业务有望保持持续增长。今年上半年，嵌入式存储产品下游仍处于库存去化状态，该业务目前仍处于送样及验证阶段，如进展顺利该业务有望于近期迎来显著增长。

5、目前订单是否存在存储模组要求完全自主可控的情形？涉及哪些应用领域？

部分客户在实际业务交流中对存储模组的国产化程度会提出一定要求，具体涵盖了信创、物联网、智慧终端等多个领域。公司自研主控芯片已经覆盖了移动存储领域，自研 SATA SSD 主控目前正处于回片验证阶段，这将有效提升在争取相关客户订单时的竞争力。

6、公司目前下游客户涨价接受幅度如何？

目前行业整体已经达成了涨价共识，但不同产品类型对应的下游应用领域景气度存在一定差异，不同厂商议价能力也存在差异，具体涨价幅度暂时无法确定。公司将根据实际情况，灵活调整产品销售价格。

7、福田智能制造基地主要是覆盖公司哪些生产环节？

公司计划于 2023 年三季度将现有大浪测试中心及贴片集成工序自有产线迁入智能制造（福田）产业基地，将主要覆盖公司晶圆检验、产品测

	<p>试、贴片制造等多个环节。未来随着智能制造（福田）产业基地信息化、自动化、专业化与流程化管理全面推进，有望提升公司存储产品先进制造水平，进一步巩固公司的核心竞争力和先进制造力。</p> <p>8、公司未来会布局 DRAM 或者封测环节么？</p> <p>公司目前积极推动的 PCIe 固态硬盘和嵌入式存储产品业务未来仍存在较大增长空间，因此短期内公司仍会依托核心竞争力专注闪存领域，聚焦主控芯片与固件方案。</p> <p>9、公司封装合作厂商主要包括哪些？</p> <p>公司合作的封装厂商较多，根据产品类型、客户要求不同，选择擅长不同封装工艺的供应商。</p> <p>10、公司目前存货情况如何，备货策略是怎么样的？三季度是否持续增长？</p> <p>截至 6 月 30 日，公司存货 9.53 亿元，其中原材料 3.18 亿元。公司考虑未来嵌入式与固态硬盘业务发展需要，增加了 Normal Wafer 的采购，适当提升战略储备。公司存货价值受影响因素较多，包括原厂的晶圆交付周期、销售情况、原材料和产品价格波动等，无法准确预估，具体请关注公司后续信息披露。</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>